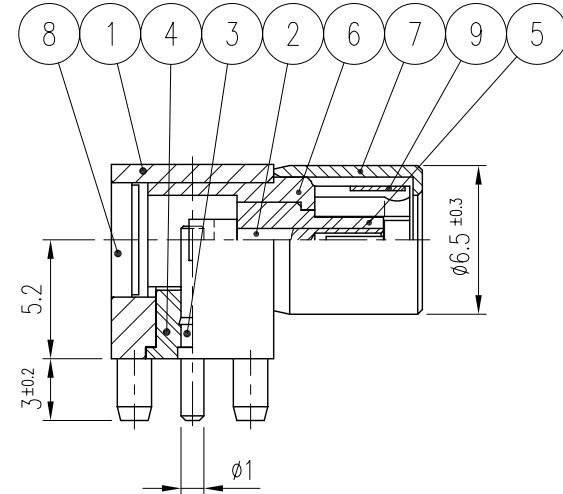
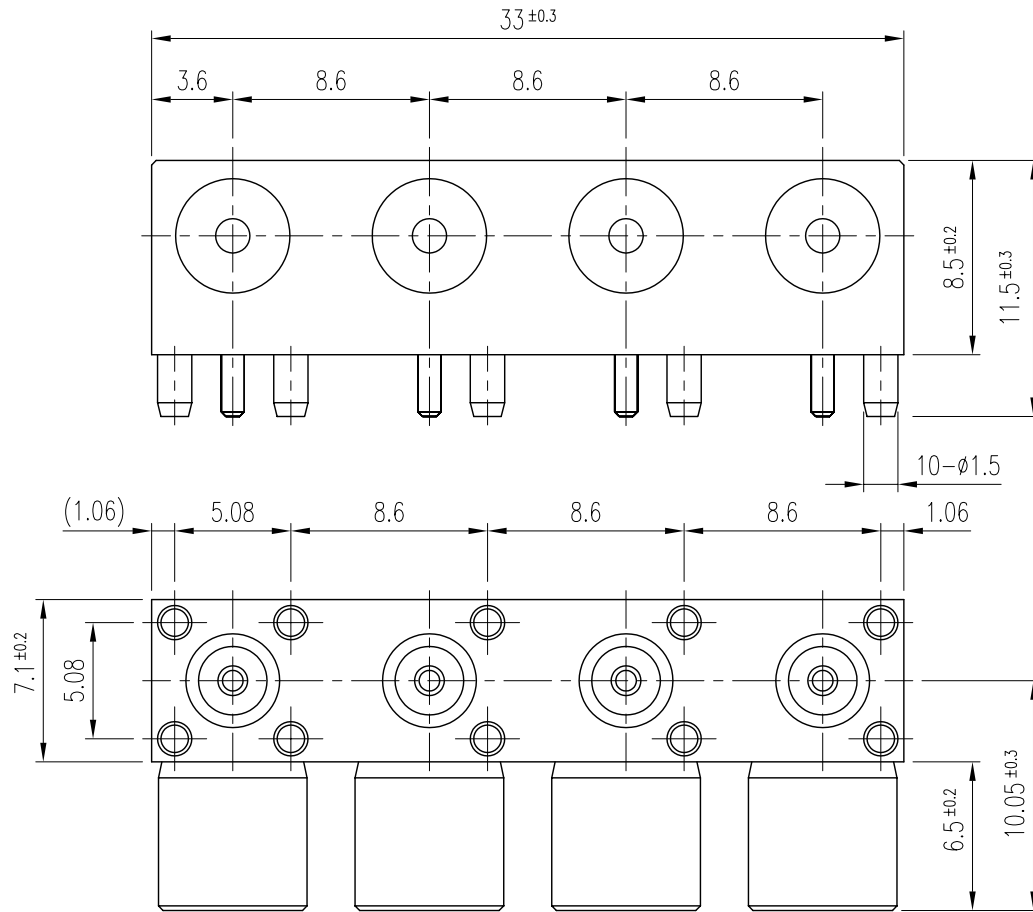


기		수 정 내 용									
ST	기	부 호		내 용		수 정 자		승 인 자		년 월 일	
ST(기초)		△									
ST(개선)		△									



9	SPRING RING	4	BeCu	Nickel Plate	DSR00073-5/1
8	COVER	4	MBsBD	Nickel Plate	DCO00034-5/1
7	CAP	4	MBsBD	Nickel Plate	DCU00025-5/1
6	JACK	4	MBsBD	Nickel Plate	DJA00037-5/1
5	INSULATOR	4	TEFLON		DIN00326-N/1
4	INSULATOR	4	TEFLON		DIN00285-N/1
3	CONTACT	4	MBsBD	Gold Plate	DCT00345-5/1
2	CONTACT	4	BeCu	Gold Plate	DCT00363-5/1
1	BODY	1	ZnDC	Nickel Plate	DBD01446-5/1

주 기

- CONTACT 부위 납땜은 고온SOLDERING(220°c)할것
- 삽입, 이탈력 : 4kgf ±2kgf
- 상대물 MALE외경 $\phi 3.66 \sim 3.71$ 이며 MAX쪽으로 관리하도록 되어있음.
(하이게인 텔레콤)
- 참 고 : PCB Hole LEG : $\phi 1.93$
Center Pin : $\phi 1.12$

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차		년월일	2006. 2. 17.				
소수 각도 분수		승인					
± 0.1 $\pm 1^\circ$		검도					
재질		재도					
열처리		검도					
보호피막처리		작성부서	연 구 소				
		적도 3/1	단위 mm	총량			



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명		SMBP-LR-PC(일체형) VER.0	
A4	도번	CN01375-7/1	
		K315-666-005	